

# 信昌電子陶瓷股份有限公司

## 2023年法人說明會

*(Stock code: 6173)*

報告日期:2023年8月18日

投資人關係聯絡人：發言人 羅夏盈  
Email：summer\_lou@pdc.com.tw  
電話：03-4753355

# 報告內容

- 公司概述
- 財務績效
- 主要市場展望
- 營業聚焦與機會

# 公司概述

## 信昌電陶

- 成立日期 1990年6月
- 資本額 新台幣17.2 億
- 員工人數 886
- 品牌 PDC
- 營業額 2022年 NT\$41.4億  
2023 H1 NT\$18.46 億



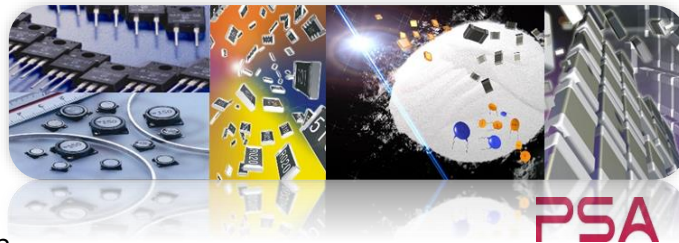
## 營運據點

- 台灣 桃園廠 / 楊梅廠
- 中國 吳江廠 / 東莞辦公室



## 生產經歷

- MLCC/CR Since 1990 (33 years)
- Powder Since 1995 (28 years)

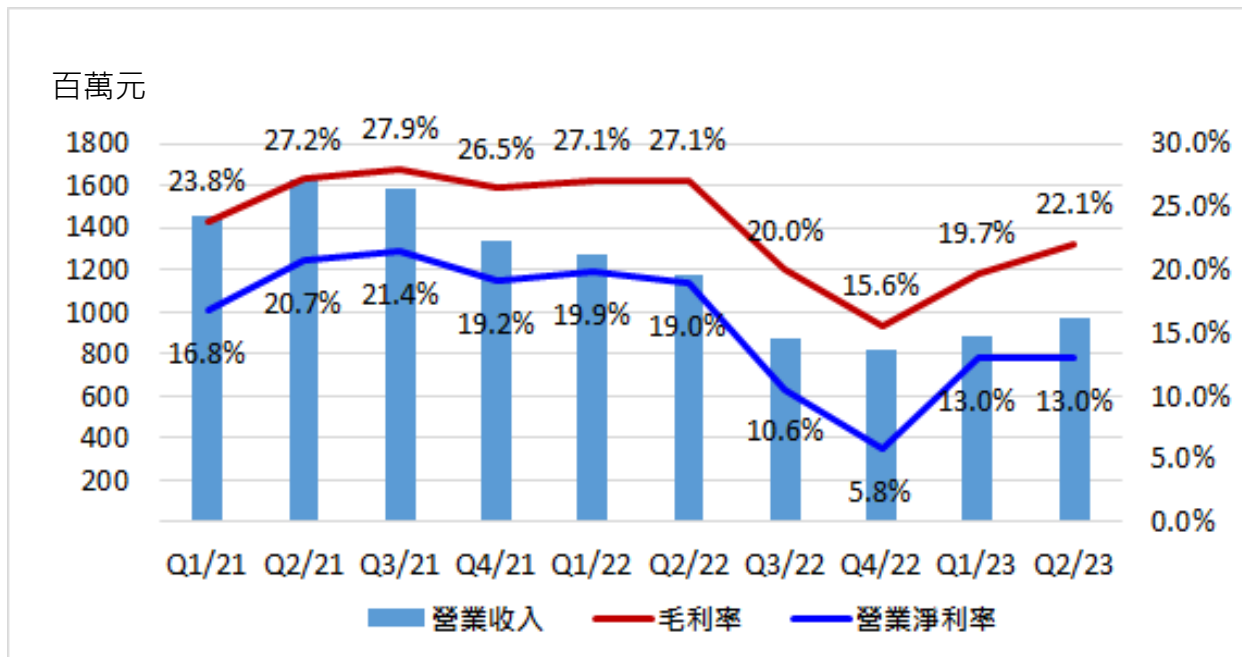


# 合併綜合損益表比較

單位:台幣百萬元;每股盈餘為元

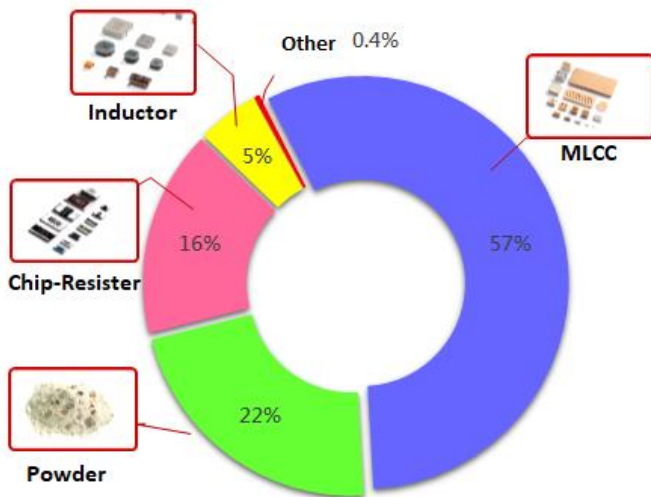
	2023 第二季	2023 第一季	QoQ	成長(%)	2023 前二季	2022 前二季	YoY	成長(%)
營業收入	966	880	86	10%	1,846	2,446	(600)	-25%
營業毛利	214	174	40	23%	387	662	(275)	-42%
毛利率(%)	22.1%	19.7%	2.4%		21.0%	27.1%	-6.1%	
營業費用	88	59	29	49%	147	186	(40)	-21%
營業淨利	126	115	11	10%	241	476	(236)	-49%
營業淨利率(%)	13.0%	13.0%	0.0%		13.0%	19.5%	-6.4%	
營業外收(支)	65	64	0	1%	129	9	119	1267%
稅前淨利	190	179	12	6%	369	486	(116)	-24%
歸屬本公司業主之稅後淨利	148	150	-1	-1%	298	398	(100)	-25%
稅後淨利率(%)	15.4%	17.0%	-1.7%		16.1%	16.3%	-0.1%	
每股盈餘(元)	0.87	0.87	0		1.74	2.32	(0.58)	

# 營收/毛利率/營業淨利率趨勢

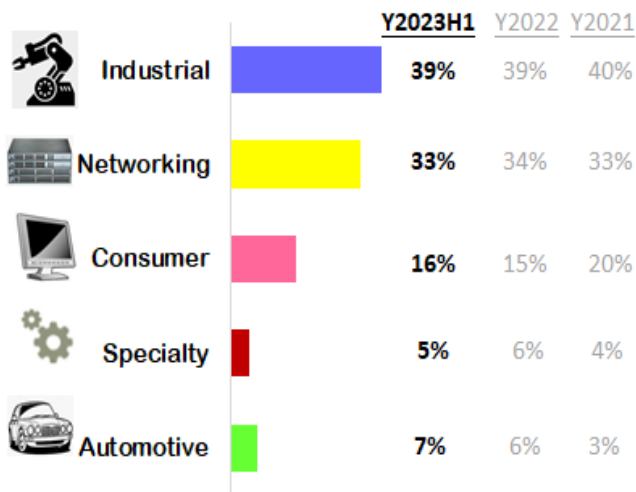


# 2023 H1營業比重

產品別銷售比重 圖1



元件產品終端應用銷售比重 圖2



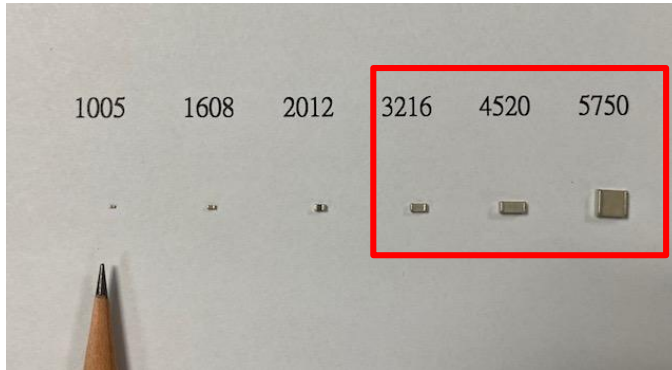
- 終端應用主要包含網通、工業、車用、航空、醫療及消費電子等相關產業。
- 安規/高功率/高耐溫/高可靠度/低損之被動元件產品及介電陶瓷粉末為本公司主力產品。

# 營業聚焦與機會

## 2021~2025 MLCC需求預估

參考資料:富士總研 單位:100萬個

年次 尺寸	2021	2022	2023	2024	2025	年平均成長率	平均用量比
<3216	5,033,000	5,298,000	5,523,000	5,720,000	5,867,000	3.31%	96.05%
>=3216	217,000	222,000	227,000	230,000	233,000	1.47%	3.95%
合計	5,250,000	5,520,000	5,750,000	5,950,000	6,100,000	3.82%	100%



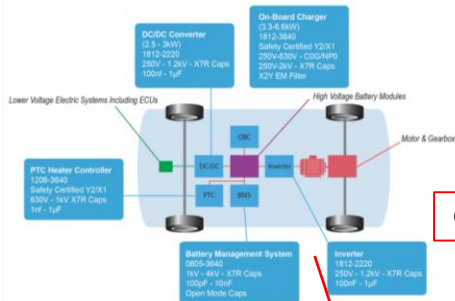
- 一般業界定義大尺寸MLCC, Chip-R主要為3216(長3.2mm\*寬1.6mm)以上(含)尺寸.
- PDC主要以生產大尺寸之被動元件為主軸,需求數量雖只佔總量約4%,但其ASP約為其他小尺寸MLCC 10倍以上.

# 產品主要應用領域

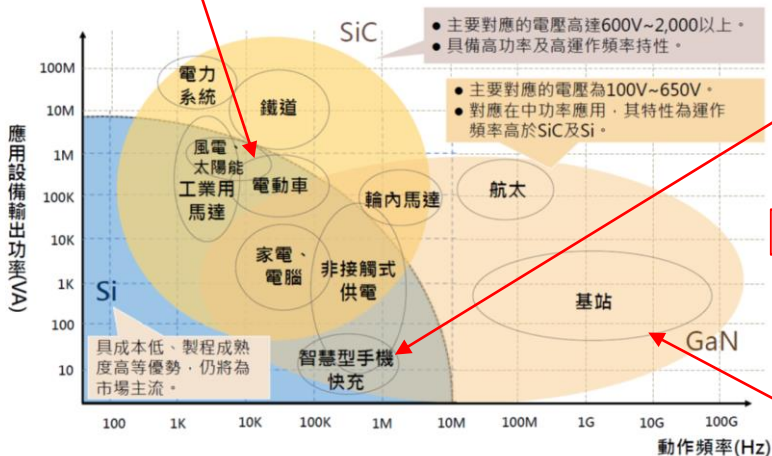
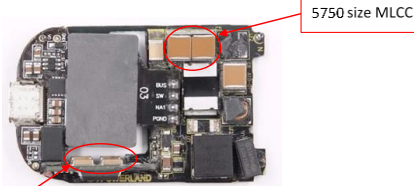




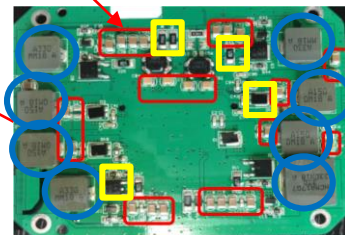
# 第三代半導體(GaN、SiC) 帶動大尺寸、高功率、特規被動元件之發展趨勢



Chip size : 3216~5750 / 50V~2000V



Chip size : 3225

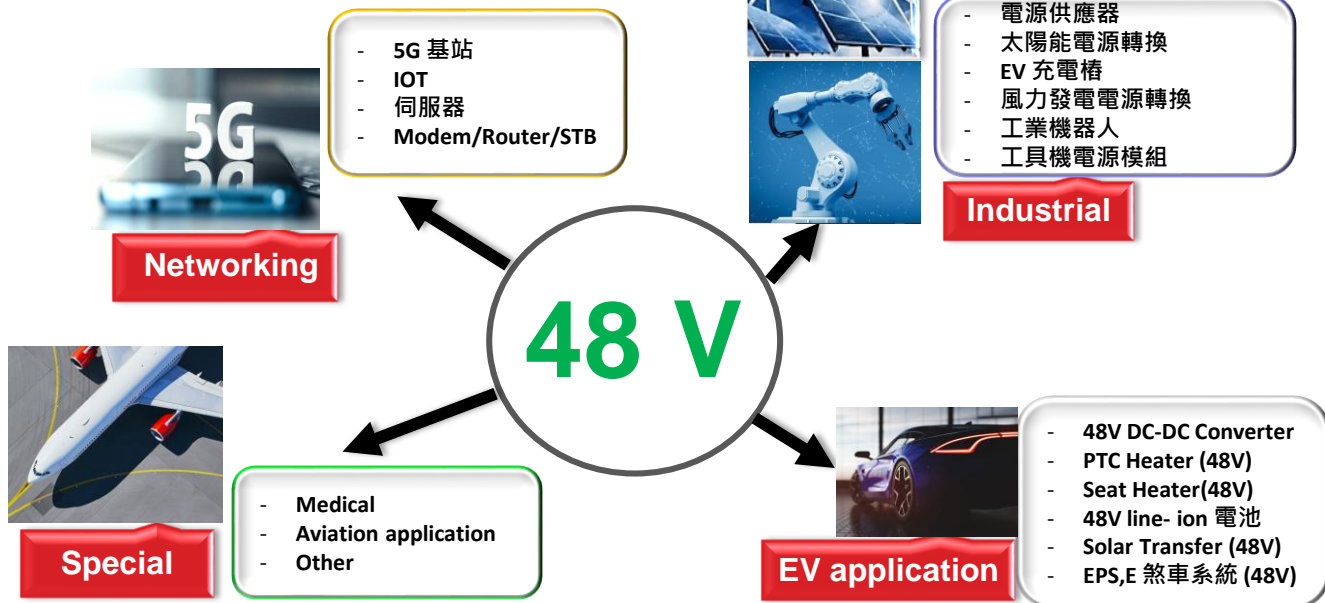


小型基站

PSA

資料來源: DIGITIMES Research

# 48V 系統應用趨勢



48V 電源輸入及輸出系統需應用100V 大尺寸MLCC 與特殊電阻

➤ 大尺寸3216以上100V MLCC

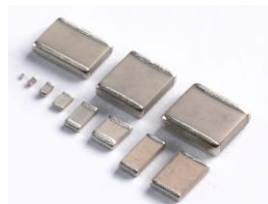


➤ 高功率,高壓,低阻貼片電阻

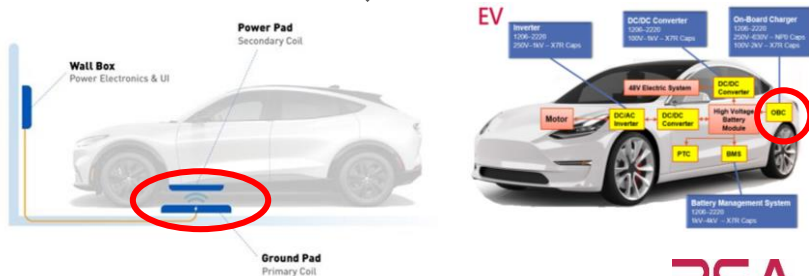
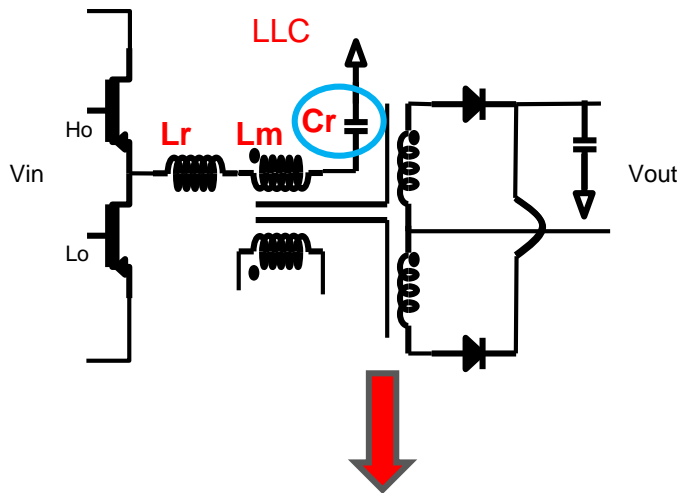


# LLC 迴路應用

LLC電路迴路應用主要大量應用於有線及無線充電裝置如EV OBC, 充電樁及將來EV 無線充電



3216以上大尺寸NPO MLCC將大量取代薄膜電容



# 機會

- 展望2023 H2,隨著EV ,Charging Station, Edge AI Hardware ,Data Center , IOT 需求提升,PDC大尺寸MLCC/ Chip-R應用機會增加.
- 隨著第三代半導體氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)的廣泛運用,將帶來PDC高功率大尺寸被動元件產品市場廣度增加.
- 高階應用產品(如EV OBC及未來車用無線充電)於設計上,大尺寸/高電壓NPO MLCC將大量取代原薄膜電容設計.
- 5G應用之射頻元件應用大量增加,進而帶動LTCC陶瓷粉末需求增加.

# 營業聚焦

- MLCC、Chip-R、Powder –
  - 因應目前客戶需求及終端應用變化，持續開發大尺寸及中高電壓之MLCC,Chip-R.
  - 具材料自主開發及製程技術能力，可有效配合中高壓及大尺寸之特殊MLCC導入高附加價值之市場，及降低成本提升競爭力.
- 介電陶瓷粉末 –
  - 持續開發高階、高溫、高壓、高容、及特殊應用MLCC介電陶瓷粉.
  - 因應5G與AI應用市場成長需求，持續開發高階及特殊應用微波粉末.
  - 持續開發各系列RF/高頻元件用LTCC材料與Cu電極製程MLCC介電陶瓷粉.
- 持續透過PSA平台進行產品整合並擴大銷售.

# Thank you!

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.